

# 2024-2030年中国芯片行业 发展趋势与未来前景预测报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

# 一、报告报价

《2024-2030年中国芯片行业发展趋势与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202406/463039.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片行业发展趋势与未来前景预测报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

### 第1章：芯片行业综述及数据来源说明

#### 1.1 芯片行业界定

##### 1.1.1 芯片的界定

##### 1.1.2 芯片相似概念辨析

##### 1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中芯片行业归属

#### 1.2 芯片行业分类

##### 1.2.1 按国际标准分类

##### 1.2.2 按使用功能分类

#### 1.3 芯片专业术语说明

#### 1.4 本报告研究范围界定说明

#### 1.5 本报告数据来源及统计标准说明

##### 1.5.1 本报告权威数据来源

##### 1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

### 第2章：中国芯片行业宏观环境分析（PEST）

#### 2.1 中国芯片行业政策（Policy）环境分析

##### 2.1.1 行业监管体系及机构介绍

###### （1）中国芯片行业主管部门

###### （2）中国芯片行业自律组织

##### 2.1.2 行业标准体系建设现状

###### （1）中国芯片行业标准体系建设

###### （2）中国芯片行业现行标准分析

##### 1) 中国芯片行业现行标准汇总

## 2) 中国芯片行业现行标准分析

### (3) 中国芯片行业重点标准解读

#### 2.1.3 国家层面芯片行业政策规划汇总及解读

##### (1) 中国芯片行业国家层面重点相关政策汇总

##### (2) 中国芯片行业国家层面重点相关规划汇总

#### 2.1.4 国家层面重点政策对芯片行业发展的影响分析

##### (1) 《2022年汽车标准化工作要点》

##### (2) 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》

#### 2.1.5 国家层面重点规划对芯片行业发展的影响分析

##### (1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

##### (2) 《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》

#### 2.1.6 中国芯片行业区域政策热力图

#### 2.1.7 中国芯片产业各省市政策汇总及解读

##### (1) 中国芯片产业各省市重点政策汇总

##### (2) 中国各省市芯片行业发展目标解读

#### 2.1.8 政策环境对行业发展的影响分析

## 2.2 中国芯片行业经济（Economy）环境分析

### 2.2.1 中国宏观经济发展现状

#### (1) 中国GDP及增长情况

#### (2) 中国三次产业结构

#### (3) 中国居民消费价格（CPI）

#### (4) 中国生产者价格指数（PPI）

#### (5) 中国工业经济增长情况

#### (6) 中国固定资产投资情况

### 2.2.2 中国宏观经济发展展望

#### (1) 国际机构对中国GDP增速预测

#### (2) 国内机构对中国宏观经济指标增速预测

### 2.2.3 中国芯片行业发展与宏观经济相关性分析

## 2.3 中国芯片行业社会（Society）环境分析

### 2.3.1 中国芯片行业社会环境分析

#### (1) 中国人口规模及增速

#### (2) 中国城镇化水平变化

- 1) 中国城镇化现状
- 2) 中国城镇化趋势展望
- (3) 中国劳动力人数及人力成本
- 1) 中国劳动力供给形式严峻
- 2) 中国人力成本持续上升
- (4) 中国网民规模及互联网普及率
- 2.3.2 社会环境对芯片行业的影响总结
- 2.4 中国芯片行业技术 ( Technology ) 环境分析
- 2.4.1 芯片行业技术工艺及流程
- 2.4.2 芯片行业新兴技术分析
- 2.4.3 中国芯片行业科研投入状况
- 2.4.4 中国芯片行业科研创新成果
- (1) 中国芯片行业专利申请公开
- 1) 专利申请数量变化情况
- 2) 专利公开数量变化情况
- (2) 中国芯片行业热门专利申请人
- (3) 中国芯片行业热门技术
- 2.4.5 技术环境对中国芯片行业发展的影响总结

### 第3章：全球芯片行业发展状况分析

- 3.1 全球芯片行业发展历程
- 3.2 全球芯片市场发展现状分析
- 3.2.1 全球芯片市场供给现状
- 3.2.2 全球芯片市场需求现状
- 3.2.3 全球芯片市场发展特点
- 3.3 全球芯片行业市场规模体量
- 3.3.1 全球半导体行业市场规模
- 3.3.2 全球芯片行业市场规模
- 3.4 全球芯片行业区域发展格局及重点区域市场研究
- 3.4.1 全球芯片行业区域发展格局
- 3.4.2 重点区域一：美国芯片行业市场分析
- (1) 美国芯片市场规模

## (2) 美国芯片技术研发进展

### 3.4.3 重点区域二：韩国芯片行业市场分析

#### (1) 韩国芯片市场规模

#### (2) 韩国芯片技术研发进展

### 3.5 全球芯片行业市场竞争格局

### 3.6 全球芯片行业发展趋势预判及市场前景预测

#### 3.6.1 新冠疫情对全球芯片行业发展影响分析

#### 3.6.2 全球芯片行业发展趋势预判

#### 3.6.3 全球芯片行业市场前景预测

## 第4章：中国芯片行业发展状况分析

### 4.1 中国芯片行业发展综述

#### 4.1.1 中国芯片产业发展历程

#### 4.1.2 中国芯片行业发展地位

### 4.2 中国芯片行业发展现状

#### 4.2.1 中国芯片市场供给情况

#### 4.2.2 中国芯片行业需求情况

#### 4.2.3 中国芯片行业市场规模（除港澳台）

### 4.3 中国芯片产业进出口贸易情况

#### 4.3.1 中国集成电路（芯片）行业进出口贸易概况

#### 4.3.2 中国集成电路（芯片）行业进口贸易状况

##### (1) 集成电路（芯片）行业进口贸易规模

##### (2) 集成电路（芯片）行业进口价格水平

##### (3) 集成电路（芯片）行业进口来源地

#### 4.3.3 中国集成电路（芯片）行业出口贸易状况

##### (1) 集成电路（芯片）行业出口贸易规模

##### (2) 集成电路（芯片）行业出口价格水平

##### (3) 集成电路（芯片）行业出口产品结构

##### (4) 集成电路（芯片）行业出口目的地

#### 4.3.4 中国集成电路（芯片）行业进出口贸易影响因素及发展趋势

### 4.4 中国芯片市场格局分析

#### 4.4.1 中国芯片市场竞争格局

(1) 区域竞争格局分析

(2) 企业竞争格局分析

#### 4.4.2 中国芯片企业最新发展动态

#### 4.5 中国芯片产业区域发展动态

##### 4.5.1 深圳

(1) 行业发展概况

(2) 行业发展现状

(3) 细分优势明显

1) IC设计环节

2) IC制造环节

3) IC封测环节

(4) 未来发展前景

##### 4.5.2 北京

(1) 行业发展概况

(2) 行业发展现状

(3) 北设计&mdash;&mdash;中关村

(4) 南制造&mdash;&mdash;亦庄

##### 4.5.3 杭州

(1) 集成电路（芯片）政策

(2) 产业发展现状

##### 4.5.4 台湾

(1) 台湾芯片行业发展历程

(2) 台湾芯片市场规模分析

(3) 台湾芯片竞争格局分析

(4) 台湾芯片技术研发进展

#### 4.6 中国芯片产业痛点与应对策略

##### 4.6.1 中国芯片产业痛点分析

##### 4.6.2 中国芯片产业痛点应对策略

### 第5章：中国芯片行业产业链分析

#### 5.1 芯片设计行业发展分析

##### 5.1.1 产业发展历程

### 5.1.2 市场发展现状

#### (1) 企业数量

#### (2) 市场规模

### 5.1.3 市场竞争格局

## 5.2 晶圆制造行业发展分析

### 5.2.1 晶圆加工技术

### 5.2.2 市场发展现状

#### (1) 晶圆产能规模

#### (2) 市场规模

### 5.2.3 市场竞争格局

## 5.3 芯片封测行业发展分析

### 5.3.1 芯片封测技术

#### (1) 芯片封装技术简介

#### (2) 芯片测试技术简介

### 5.3.2 市场发展现状

#### (1) 主要企业产量

#### (2) 市场规模

### 5.3.3 市场竞争格局

## 第6章：芯片行业细分产品市场分析

### 6.1 芯片行业产品结构概况

#### 6.1.1 芯片产品类型介绍

#### 6.1.2 芯片产品结构分析

### 6.2 模拟芯片市场分析

#### 6.2.1 模拟芯片概况

##### (1) 模拟芯片概况

##### (2) 模拟芯片分类

#### 6.2.2 模拟芯片市场规模

##### (1) 全球模拟芯片市场规模

##### (2) 中国模拟芯片市场规模

#### 6.2.3 模拟芯片市场竞争格局

##### (1) 全球模拟芯片竞争格局



## (2) 中国模拟芯片竞争格局

### 6.2.4 模拟芯片的下游应用

## 6.3 微处理器市场分析

### 6.3.1 微处理器分类

### 6.3.2 微处理器市场规模

#### (1) 全球微处理器市场规模

#### (2) 中国微处理器市场规模

### 6.3.3 微处理器市场竞争格局

#### (1) 全球微处理器的竞争格局

#### (2) 中国微处理器的竞争格局

### 6.3.4 微处理器的下游应用

## 6.4 逻辑芯片市场分析

### 6.4.1 逻辑芯片分类

### 6.4.2 逻辑芯片市场规模

#### (1) 全球逻辑芯片市场规模

#### (2) 中国逻辑芯片市场规模

### 6.4.3 逻辑芯片市场竞争格局

#### (1) 计算机处理器（CPU）市场竞争格局

#### (2) 计算机图形处理器（GPU）市场竞争格局

### 6.4.4 逻辑芯片的下游应用

## 6.5 存储器市场分析

### 6.5.1 存储器分类

### 6.5.2 存储器市场规模

#### (1) 全球存储器市场规模

#### (2) 中国存储器市场规模

### 6.5.3 存储器市场竞争格局

#### (1) 细分产品竞争格局

#### (2) 企业竞争格局

### 6.5.4 存储器的下游应用

## 6.6 中国芯片行业未来细分产品——量子芯片发展进程分析

### 6.6.1 量子芯片概述

### 6.6.2 产品发展历程

### 6.6.3 市场发展形势

### 6.6.4 产品研发动态

## 第7章：中国芯片产业下游应用市场分析

### 7.1 5G

#### 7.1.1 行业发展背景

#### 7.1.2 5G芯片市场发展现状

#### 7.1.3 5G芯片市场竞争格局

#### 7.1.4 5G芯片发展趋势

### 7.2 自动驾驶

#### 7.2.1 行业发展背景

#### 7.2.2 自动驾驶芯片市场发展现状

#### 7.2.3 自动驾驶芯片市场竞争格局

#### 7.2.4 自动驾驶芯片发展前景

### 7.3 AI

#### 7.3.1 行业发展背景

#### 7.3.2 AI芯片市场发展现状

#### 7.3.3 AI芯片市场竞争格局

#### 7.3.4 AI芯片发展趋势

### 7.4 智能穿戴设备

#### 7.4.1 行业发展背景

#### 7.4.2 智能穿戴设备芯片市场发展现状

#### 7.4.3 智能穿戴设备芯片市场竞争格局

#### 7.4.4 智能穿戴设备芯片发展趋势

### 7.5 智能手机

#### 7.5.1 行业发展背景

#### 7.5.2 智能手机芯片市场发展现状

#### 7.5.3 智能手机芯片市场竞争格局

#### 7.5.4 智能手机芯片发展趋势

### 7.6 服务器

#### 7.6.1 行业发展背景

#### 7.6.2 服务器芯片市场发展现状

### 7.6.3 服务器芯片市场竞争格局

### 7.6.4 服务器芯片发展趋势

## 7.7 个人计算机

### 7.7.1 行业发展背景

### 7.7.2 个人计算机芯片市场发展现状

#### (1) 计算机CPU芯片发展现状

#### (2) 计算机GPU芯片发展现状

### 7.7.3 个人计算机芯片市场竞争格局

#### (1) 计算机CPU芯片竞争格局

#### (2) 计算机GPU芯片竞争格局

### 7.7.4 个人计算机芯片发展趋势

## 第8章：芯片行业领先企业案例分析

### 8.1 芯片综合型企业案例分析

#### 8.1.1 英特尔

##### (1) 企业基本信息

##### (2) 经营效益分析

##### (3) 企业产品结构

##### (4) 技术工艺开发

##### (5) 未来发展战略

#### 8.1.2 三星

##### (1) 企业基本信息

##### (2) 经营效益分析

##### (3) 企业产品结构

##### (4) 芯片行业发展

##### (5) 技术工艺开发

##### (6) 未来发展战略

#### 8.1.3 高通公司

##### (1) 企业基本信息

##### (2) 经营效益分析

##### (3) 企业业务结构

##### (4) 技术工艺开发

(5) 未来发展战略

#### 8.1.4 英伟达

(1) 企业基本信息

(2) 经营效益分析

(3) 企业业务结构

(4) 技术工艺开发

(5) 未来发展战略

#### 8.1.5 AMD

(1) 企业发展概况

(2) 企业业务结构

(3) 技术工艺开发

(4) 未来发展战略

#### 8.1.6 SK海力士

(1) 企业基本信息

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 芯片行业发展

(5) 未来发展战略

#### 8.1.7 德州仪器

(1) 企业发展概况

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 企业区域分布

(5) 未来发展战略

#### 8.1.8 美光（镁光）

(1) 企业发展概况

(2) 经营效益分析

(3) 企业产品结构

(4) 芯片行业发展

(5) 技术工艺开发

(6) 未来发展战略

#### 8.1.9 联发科技

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 企业销售区域分布
- (5) 技术工艺开发
- (6) 未来发展战略

#### 8.1.10 海思

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 技术工艺开发
- (5) 最新发展动态

### 8.2 芯片设计重点企业案例分析

#### 8.2.1 博通有限公司

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 收购动态分析

#### 8.2.2 Marvell

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业产品结构
- (4) 未来发展战略

#### 8.2.3 赛灵思

- (1) 企业基本信息
- (2) 企业产品结构
- (3) 收购动态分析

#### 8.2.4 紫光展锐

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 产品研发进展
- (4) 收购动态分析

### 8.3 晶圆代工重点企业案例分析

#### 8.3.1 格芯

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 晶圆代工业务
- (4) 技术工艺开发
- (5) 企业发展战略

#### 8.3.2 台积电

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 公司晶圆代工业务
- (4) 产品研发进展
- (5) 技术工艺开发
- (6) 企业发展战略

#### 8.3.3 联电

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 晶圆代工业务
- (4) 技术工艺开发
- (5) 未来发展战略

#### 8.3.4 力积电

- (1) 企业基本信息
- (2) 经营效益分析
- (3) 晶圆代工业务
- (4) 技术工艺开发

#### 8.3.5 中芯国际

- (1) 企业基本信息
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业晶圆代工业务分析
- (5) 企业技术水平分析
- (6) 企业营销网络分析

#### 8.3.6 华虹

- (1) 企业基本信息
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业晶圆代工业务
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析

#### 8.4 芯片封测重点企业案例分析

##### 8.4.1 Amkor

- (1) 企业发展简介
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业销售区域分布
- (4) 企业在中国市场投资布局情况

##### 8.4.2 日月光

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业财务情况分析
- (3) 企业主营产品及应用领域

##### 8.4.3 南茂

- (1) 企业发展概况
- (2) 经营效益分析
- (3) 企业业务结构
- (4) 企业营销网络分析

##### 8.4.4 长电科技

- (1) 企业基本信息
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析

##### 8.4.5 天水华天

- (1) 企业基本信息
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析

- (4) 企业营销网络分析

#### 8.4.6 通富微电

- (1) 企业基本信息

- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析

- (4) 企业营销网络分析

### 第9章：中国芯片行业前景趋势预测与投资建议

#### 9.1 芯片行业发展前景与趋势预测

##### 9.1.1 行业发展前景预测

- (1) 芯片总体前景预测

- (2) 芯片细分领域前景预测

##### 9.1.2 行业发展趋势预测

- (1) 芯片行业技术发展趋势

- (2) 行业产品发展趋势预测

- (3) 行业市场竞争趋势预测

#### 9.2 芯片行业投资潜力分析

##### 9.2.1 行业投资现状分析

##### 9.2.2 行业进入壁垒分析

- (1) 技术壁垒

- (2) 人才壁垒

- (3) 资金实力壁垒

- (4) 产业化壁垒

- (5) 客户维护壁垒

##### 9.2.3 行业经营模式分析

##### 9.2.4 行业投资风险预警

- (1) 政策风险

- (2) 宏观经济风险

- (3) 供求风险

- (4) 其他风险

#### 9.3 芯片行业投资策略与建议

##### 9.3.1 行业投资价值分析



- (1) 行业发展空间较大
- (2) 行业政策扶持利好
- (3) 下游应用市场增长迅速

### 9.3.2 行业投资机会分析

- (1) 宏观环境改善
- (2) 芯片设计业被看好
- (3) 产业转移
- (4) 网络通信领域依然是核心
- (5) 智能家居等市场芯片需求强劲
- (6) 小型化和立体化封装技术具有发展潜力

### 9.3.3 行业投资策略分析

- (1) 不断强化技术创新
- (2) 积极开展跨境并购
- (3) 重视知识产权保护
- (4) 深入开展国际与国内合作
- (5) 加大高端人才的引进力度

## 图表目录

图表1：半导体、芯片和集成电路概念区分

图表2：《国民经济行业分类（2017版）》中芯片行业所归属类别

图表3：按电路对芯片进行分类

图表4：不同功能的芯片介绍

图表5：芯片专业术语说明

图表6：本报告研究范围界定

图表7：本报告权威数据资料来源汇总

图表8：本报告的主要研究方法及其统计标准说明

图表9：中国芯片行业监管体系构成

图表10：中国芯片行业主管部门

图表11：中国芯片行业自律组织

图表12：截至2022年中国芯片行业标准体系建设（单位：项）

图表13：截止到2022年中国芯片行业的国家标准

图表14：截止到2022年中国芯片行业的行业标准

图表15：截止到2022年中国芯片行业的地方标准

图表16：截止到2022年中国芯片行业的企业标准

图表17：截止到2022年中国芯片行业的团体标准

图表18：截至2022年中国芯片行业现行标准属性分布（单位：项，%）

图表19：中国芯片行业重点标准解读

图表20：截止到2022年中国芯片行业国家层面重点相关政策汇总

图表21：截止到2022年中国芯片行业国家层面重点相关规划汇总

图表22：《2022年汽车标准化工作要点》有关芯片行业的指导内容

图表23：《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》关于芯片行业的内容

图表24：《“十四五”规划》关于芯片行业发展建设规划

图表25：《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》有关芯片行业的指导内容

图表26：截至2022年中国芯片行业区域政策热力图（单位：条）

图表27：中国各省市芯片产业主要政策汇总及解读

图表28：2025年中国芯片行业主要省市发展目标解读

图表29：政策环境对中国芯片行业发展的影响总结

图表30：2010-2022年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202406/463039.html>